

TCFD提言に基づく気候変動関連の情報開示について

1. ガバナンス

気候関連リスクおよび機会についてのガバナンス体制

当社グループでは、「SCREENグループリスクマネジメント要綱」および関連規定に基づいて、ビジネスリスクの洗い出しとその軽減に向けた取り組みを行うとともに、持株会社がグループ全体のリスクマネジメント状況を把握する仕組みを運用しています。

SCREENグループの企業価値にマイナスの影響を及ぼすリスクを軽減するため、取締役社長を最高責任者とし、取締役会の監督下で権限を委譲された「グループリスク委員会」において、気候関連リスクを含むSCREENグループ全体を俯瞰したリスクの洗い出しと重要リスクの特定を行い、リスク管理の方向性を定める取り組みを行っています。また、同じく取締役社長を責任者とする「CSR委員会」においては、気候関連のリスクと機会を含む環境・社会の課題について協議し、目標の設定と進捗管理を行っています。各委員会は半期に1回以上開催され、その場で承認された内容は必要に応じて取締役会で決議または報告されます。

また、気候変動関連の情報開示に際し、当社グループでは外部専門家を交えたTCFDプロジェクトを立ち上げ、主要事業に対して、シナリオ分析およびリスクと機会の再評価を進めています。2022年3月期は半導体製造装置事業を対象に、そして2023年3月期はディスプレイ製造装置および成膜装置事業¹とグラフィックアーツ事業の2事業を対象にプロジェクトを展開し、活動の結果を取締役に報告しました。

気候関連のガバナンス体制における役割

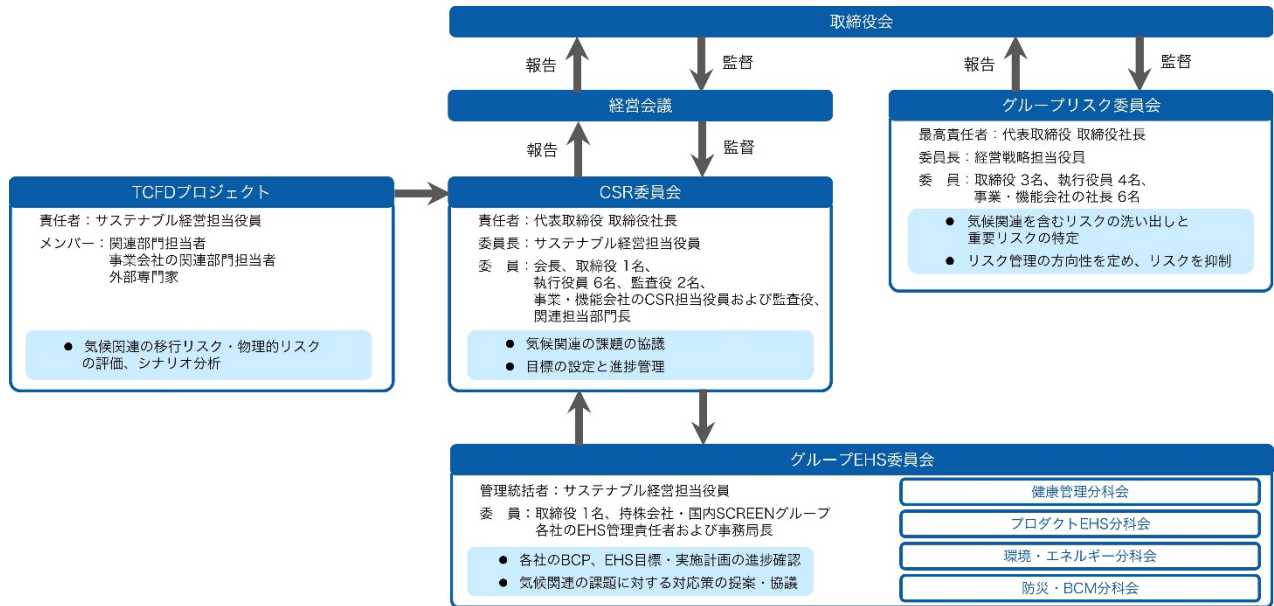
当社グループでは、グループ委員会の運営によってグループ全体のコーポレート・ガバナンスの強化を図っており、各委員会では目的に応じたモニタリングや議論を行い、適宜、取締役会など定められた機関に報告しています。2023年3月期、気候変動関連では「TCFD対応プロジェクト」や「SBT目標の1.5°C対応への見直し・2050年カーボンニュートラル宣言」などを、経営会議および取締役会に報告しました。

気候変動対応と役員報酬との連動

取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」、短期の業績連動報酬としての「業績連動型報酬」、短期から中長期の業績、企業価値に連動する「業績連動型株式報酬」の3つから構成されています。業績連動型報酬額を測る指標には、営業利益率、ROEに加えて、社会的価値向上として環境・安全の指標などを用い、各指標の達成度を点数換算して報酬の額を決定しています。なお、気候変動対応については、社会的価値向上の中期計画である「Sustainable Value 2023」に沿って、事業活動によるCO₂排出量の削減目標を指標として組み込んでいます。

¹ 2023年3月期のTCFDプロジェクトでは、エネルギー分野（水素関連事業）については、ディスプレイ製造装置および成膜装置事業に含めてシナリオ分析を実施しました。2023年4月には持株会社に水素関連事業室を新設し、SCREENファインテックソリューションズから水素関連事業を移管しています。

気候関連のガバナンス体制の模式図



※ 特に記載のない限り、持株会社を指しています。

2. 戦略

気候関連リスクおよび機会

2022年3月期の半導体製造装置事業に続き、2023年3月期はディスプレイ製造装置および成膜装置事業とグラフィックアーツ機器事業の2事業を対象に、気候関連の移行リスク・物理リスクを評価し、重要なリスクの特定とシナリオ分析を実施しました。また、気候関連の事業機会についても特定しています。

さらに2024年3月期には、プリント基板関連機器事業を対象とした評価を予定しており、これによって当社グループの主要4事業における評価が一巡することになります。なお、2023年3月期までに評価を実施済みの3事業についても、定期的な評価の見直しや対応策の実施を進めていきます。

当社グループにおける気候関連の重要なリスクと機会

重要なリスク・機会			想定される影響
移行 リ ス ク	政策・ 法制度	既存の製品およびサービスに対する、命令および規制	原材料調達の見直しなどサプライチェーンの再構築や、製品の設計、製造プロセスの見直しにより、コストが発生する。
	技術	新技術への投資 (技術開発への影響)	エネルギー消費を低減する新技術を開発できない、あるいは、エネルギー効率を高める新技術への移行のコストが非常に高くなる。
	市場	顧客行動の変化 (製品に対するニーズ)	より低炭素な製品への需要に対して、エネルギー消費、CO ₂ 排出量の少ない半導体製造装置を開発できず、受注の減少、機会損失が発生する。
		顧客行動の変化 (サプライチェーンへの排出量の削減要請)	自社の製造拠点における排出量の削減に加え、使用する原材料でのCO ₂ 排出量の削減が必要となり、原材料の見直しに伴うコストが発生する。
		エネルギー市場の変化 (水素活用の拡大に応じた技術開発、製造キャパシティーの増強、生産コストの低減)	水素活用の拡大に応じたMEA (Membrane Electrode Assembly) の量産化技術の開発や迅速な製造キャパシティーの増強、生産コスト低減が図れず、拡大する市場の需要に対して機会損失が発生する。
	評判	顧客からの評判変化	自社のCO ₂ 排出量削減の遅れが、顧客が取引先に求める基準の未達やステークホルダーの評判低下を招き、受注が減少するリスクが発生する。
		優良な人的資源の確保	気候変動への対応の遅れにより、研究開発などの人材の採用が困難になる。

機会	製品 および サービス	R&Dおよび技術革新を通じた新製品やサービスの開発 (顧客の製造過程への省エネ貢献)	エネルギー消費の少ない製造装置に対するニーズが高まり、これに応えることで売り上げが増加する。 他社に比べ顧客の「Scope2」を少しでも削減する低消費電力製品の提供を行うことで、受注の機会が増える。
		顧客からのESG対応に関する要請への対応	気候変動への対応が評価され、ブランドイメージが向上した結果、半導体製造装置の売り上げが増加する。
		異常気象の激甚化と頻度の上昇 (顧客での水利用可能性の変化の影響)	水および薬液消費量のより少ない半導体製造装置や、使用する水の再生機能 (Water recycling system) を持つ半導体製造装置の販売機会が増加することにより、売り上げが増加する。
	市場	R&Dおよび技術革新を通じた新製品やサービスの開発 (半導体の高性能化、低消費電力化による需要増。データセンター、5G移動通信、AI向け)	微細化技術などの開発により、省エネの加速化に貢献する最先端半導体の製造に対応できる半導体製造装置の売り上げが増加する。
		製品の製造・販売やサービスの提供 (省エネに貢献するパワー半導体の需要増)	パワー半導体の製造に使用する半導体製造装置の売り上げが増加する。
		製品の製造・販売やサービスの提供 (水素の活用拡大に伴うMEAの需要増)	バス・トラックなどの燃料電池自動車 (FCV) 向けや水素を製造する水電解装置に使用するMEAの売り上げが増加する。

シナリオ分析の前提

半導体製造装置事業、ディスプレイ製造装置および成膜装置事業、グラフィックアーツ機器事業を対象として特定した気候関連の重要なリスクと機会について、2030年における財務影響を、3°Cシナリオと1.5°Cシナリオを使用して評価しました。

2020年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定が目指す世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して、2°Cより十分低く抑え、1.5°Cに抑えるよう努力することを考慮し、当社グループは地球温暖化対策が進まない現状維持のシナリオである3°Cシナリオ (STEPS: Stated Policies Scenario) と地球温暖化対策が進む1.5°Cシナリオ (NZE: Net Zero emissions by 2050 Scenario) を選定しました。

シナリオ分析のプロセス

事業会社および持株会社の関連部門担当者に外部専門家を交えたプロジェクトにおいて、以下の手順に従って事業ごとにシナリオ分析を実施しました。その際、事業会社および持株会社の経営層に説明し、方向性を確認しました。

1. 各事業にとって重要な気候関連のリスク・機会の検討
2. シナリオの検討、作成
3. シナリオを基にしたリスク・機会の評価と、財務影響の評価
4. 対応策の検討

シナリオの検討、作成においては、国際エネルギー機関(IEA)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表する複数の既存シナリオに加えて、環境省・気象庁の「21世紀末における日本の気候」「気候変動の観測・予測・影響評価に関する統合レポート2018 ～日本の気候変動とその影響～」、経済産業省の「半導体戦略」(2021年6月)、内閣官房などの「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」など多数の情報源を参照し、2030年の状況を想定しました。

シナリオの概要

シナリオの概要（2030年の想定）

	3°Cシナリオ	1.5°Cシナリオ
政策・法規制	<ul style="list-style-type: none"> カーボンプライシング（炭素税・排出権取引）の導入は部分的にとどまる。 想定炭素価格：60ドル 	<ul style="list-style-type: none"> カーボンプライシング（炭素税・排出権取引）が導入される。樹脂の使用削減の施策が拡大する。 想定炭素価格：130ドル
技術	<ul style="list-style-type: none"> エネルギー消費やCO₂排出量が少ない半導体製造装置の開発は、それほど進まない。 	<ul style="list-style-type: none"> エネルギー消費やCO₂排出量が少ない半導体製造装置の開発が進む。
市場	<ul style="list-style-type: none"> 半導体市場は2020年比で2倍に増加。 半導体産業では、エネルギーの使用に伴う排出の削減はそれほど進まない。 燃料電池自動車などへの水素の活用が進む。 	<ul style="list-style-type: none"> 半導体市場は2020年比で2倍に増加、パワー半導体の需要も伸びる。 電気自動車の販売台数は3°Cシナリオの2倍になる。 再エネ需要が増加し、再エネ調達価格が上昇する。 燃料電池自動車などへの水素の活用、需要に応じた水素製造が大幅に拡大する。
評判	<ul style="list-style-type: none"> 気候変動の取り組みの評価は、それほど重視されない。 労働市場において、優良な人材におけるサステナビリティへの関心も、それほど高まっていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 気候変動の取り組みの評価が強まる。 気候変動を含む社会課題に貢献している企業への就職希望が増える。
物理リスク	<ul style="list-style-type: none"> 異常気象が激甚化し、頻度が上昇。台風の強度が強まる。 日本国内の降雨強度が増大し、彦根事業所や一部のサプライヤーの拠点での浸水リスクが上昇する。 台湾などでは渇水リスクが上昇する。 	

シナリオ分析の結果

シナリオ分析の結果と財務影響（当社グループにおける重要なリスクと機会）

リスク・機会の種類		リスク・機会の内容	財務影響	3°C シナリオ	1.5°C シナリオ
移行 リスク	政策・ 法制度	既存の製品およびサービスに対する、命令および規制	製造コストの増加	小	中
	技術	新技術への投資 (技術開発への影響)	開発コストの増加	中	中
	市場	顧客行動の変化 (製品に対するニーズ)	売上高の減少	中	大
		顧客行動の変化 (サプライチェーンへの排出量の削減要請)	製造コストの増加	中	中
		エネルギー市場の変化 (水素活用の拡大に応じた技術開発、製造キャパシティーの増強、生産コストの低減)	売上高の減少	小	中
	評判	顧客からの評判変化	売上高の減少	小	中
		優良な人的資源の確保	管理コストの増加	小	中
機会	製品 および サービス	R&Dおよび技術革新を通じた新製品やサービスの開発 (顧客の製造過程への省エネ貢献)	売上高の増加	中	大
		顧客からのESG対応に関する要請への対応	売上高の増加	小	中
		異常気象の激甚化と頻度の上昇 (顧客での水利用可能性の変化の影響)	売上高の増加	中	中
	市場	R&Dおよび技術革新を通じた新製品やサービスの開発 (半導体の高性能化、省エネ化による需要増。データセンター、スマートフォン、AI向け)	売上高の増加	大	大
		製品の製造・販売やサービスの提供 (省エネに貢献するパワー半導体の需要増)	売上高の増加	中	中
		製品の製造・販売やサービスの提供 (水素活用拡大に伴うMEAなどの需要増)	売上高の増加	小	大

2030年を想定した財務影響 小：2%未満、中：2%～10%未満、大：10%～30%

物理リスクに関しては、自社製造拠点や主要サプライヤーにおける浸水リスクなどが抽出され、拠点・事業ごとにシナリオ分析を行いました。事業継続の観点から製造拠点の浸水対策やサプライチェーンの複線化などの対応を実施してきた成果もあり、2030年時点における影響は小さいと評価しています。

財務影響評価

<半導体製造装置事業>

気候変動への意識の高まりにより、製品の環境インパクトにも関心が集まっています。多くの顧客は、カーボンフットプリントのより低い製品を志向しています。今後、販売先での当社製品の稼働に伴う、消費電力やCO₂排出量がより少ない半導体製品への要求がますます高まることが想定されます。このような市場の変化に対して、エネルギー消費、CO₂排出量の少ない製品装置を開発できず、受注の減少、機会損失を招いた場合、1.5°Cシナリオでは売上高が減少する影響があると考えます。

また逆に、R&Dおよび技術革新を通じた新製品やサービスの提供により、顧客事業所の省エネに貢献できた場合は、売上高が増加すると考えます。

加えて、1.5°Cシナリオによるデジタルとグリーン社会への投資ニーズの高まりにより、最先端半導体の製造に対応できる半導体製造装置、パワー半導体の製造に使用する半導体製造装置の売り上げが増加する、大きな機会があります。これらの機会を創出できれば、売上高をさらに増加させることができると考えます。

<ディスプレイ製造装置および成膜装置事業>

ディスプレイ製造工程で使われる成膜技術を応用展開し、燃料電池の重要部材であるMEA (Membrane Electrode Assembly) など、水素の活用に関連する製品の製造・販売やサービスの提供を行っています。今後、燃料電池自動車 (FCV) 向けをはじめ水素の活用が広がっていくと想定され、特に1.5°Cシナリオにおいては、水素の製造を含む関連市場が大幅に拡大することが期待されます。

このような市場の変化に対して、量産化技術の開発や迅速な製造キャパシティーの増強、生産コストの低減が図れない場合、拡大する市場に対して機会損失が発生し、売上高が減少すると考えます。一方で、市場の変化に対応できた場合には、バス・トラックなどの燃料電池自動車向けや水素製造用のMEAの売上高が増加すると考えます。

ディスプレイ製造装置に関しては、特に1.5°Cシナリオにおいて、製品の稼働に伴う消費電力やCO₂排出量がより少ない製品へのニーズが高まることが想定されます。開発コストの増加などのリスクが想定される一方、顧客の事業所における省エネルギーに貢献できた場合は、売上高が増加する機会になると考えますが、これらの気候変動によって生じるリスクや機会の影響は、グループ全体から見ると相対的に小さいと評価しています。

<グラフィックアーツ機器事業>

グラフィックアーツ機器に関しては、特に1.5°Cシナリオにおいて、顧客の脱炭素に向けた要求やエネルギー効率への選好が高まることが想定され、開発投資の増加や開発遅延のリスクが想定される一方、エネルギー・資源効率の高い製品やライフサイクル全体のCO₂排出量が小さい製品に対する販売機会が生じると期待されます。ただし、気候変動によって生じるこれらのリスクや機会の影響は、グループ全体から見ると相対的に小さいと評価しています。

気候変動への取り組み・対応策

顧客の要求を満たす環境性能を備えられるよう、事業活動によるCO₂排出量 (Scope1+Scope2) に加え、販売した製品の使用によるCO₂排出量 (Scope3カテゴリ-11) の、2030年における削減目標について、Science Based Targets (SBT) として認定を受け、サプライチェーンの排出も含めたCO₂排出量の削減に取り組んでいます。

事業活動によるCO₂排出量の削減は、再生可能エネルギーの導入や事業所設備の省エネルギー化など、販売した製品の使用によるCO₂排出量の削減は、環境性能が高い「グリーンプロダクツ」や「スーパーグリーンプロダクツ」の開発の推進による製品のエネルギー消費量の効率化などに注力しています。

また、2050年のカーボンニュートラルを見据えた気候変動への対応を一層加速させる観点から、2025年3月期から始まる次期中期経営計画の策定に合わせて、気温上昇を1.5°Cに抑制するために総合的な水準へとCO₂排出量削減目標を見直すことを含め、脱炭素社会への移行に向けた具体的な事業計画の検討を進めています。

なお、物理的リスクに関しては、2030年時点における影響は小さいと評価しています。しかし、激甚化する地震や台風・水害などの自然災害、感染症パンデミック、工場における事故など、事業継続に支障を来す恐れのあるリスクを対象に、顧客への製品・サービスの供給責任を果たすための早期の復旧体制が重要であると考え、実効性のある事業継続計画 (BCP) の展開・強化を進めています。

<半導体製造装置事業>

エネルギー消費量、水および薬液消費量のより少ない半導体製造装置や、省エネルギー化に貢献する先端半導体の製造を実現する半導体製造装置のニーズに応えるため、研究開発に注力しています。また、より効果的な環境対応開発を行い、環境性能の高い装置を業界に提供していくため、製品およびサービス別にCO₂排出量の可視化を進めています。

当社グループ単独での取り組みに加えて、環境対応開発を一層加速させるため、業界他社や業界団体と協働しています。例えば、コラボレーションや情報発信を通じて先進的な気候変動対策を推進する「半導体気候関連コンソーシアム (Semiconductor Climate Consortium)」や、ベルギーの研究機関である「imec (Interuniversity Microelectronics Centre)」が進める半導体業界全体の環境負荷低減に関する研究プログラムに参画しています。また、装置稼働時における省エネルギー化、化学薬品の使用量や廃液の削減を目指し、IBM社と次世代デバイスにおける洗浄プロセスに関する共同開発を行っている他、「新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)」における先端半導体の前工程技術 (微細化技術) の開発事業にも共同参画しています。

<ディスプレイ製造装置および成膜装置事業>

今後の水素活用の拡大を見据え、MEAの量産事業を開始しました。また、グリーン水素を生み出す水電解技術の共同開発に着手し、グリーン水素製造の低コスト化に向けた技術開発を進めています。機会の創出と「脱炭素・水素社会」実現への貢献に向け、ディスプレイ製造装置事業で培った直接塗工などの技術と、グループの持つ製造プロセスのノウハウを結集し、取り組んでいます。

ディスプレイ製造装置についても、製品使用時のエネルギー消費量の削減をはじめとする環境負荷低減の取り組みを継続し、顧客要求を満たす技術・製品ソリューションの提供に努めていきます。

<グラフィックアーツ機器事業>

エネルギー効率・資源効率の高い印刷機器の開発、リサイクルしやすい素材や多品種小ロット印刷への対応など、顧客や世の中の変化に対応した技術・製品ソリューションの提供により、事業機会の創出・拡大に努めていきます。

3. リスク管理

気候関連のリスク管理のプロセス

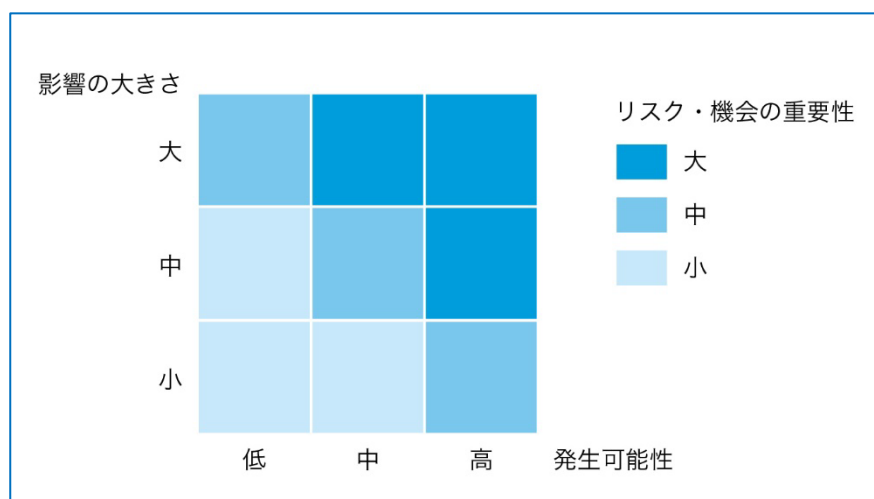
当社グループでは、「グループリスク委員会」で、気候関連リスクを含むSCREENグループ全体を俯瞰したリスクの洗い出しと重要リスクの特定を行い、リスク管理の方向性を定める取り組みを行っています。

2022年3月期に実施した半導体製造装置事業に続き、2023年3月期はTCFDプロジェクト活動においてディスプレイ製造装置および成膜装置事業、グラフィックアーツ機器事業に関して分析を行い、バリューチェーンの活動として「商品企画」「原材料調達」「購買物流」「製造」「出荷物流」「販売・マーケティング」「アフターセールスサービス」「顧客での製品の使用」「製品の廃棄・リサイクル」の項目、サポート活動として「技術開発」「全般管理（経理、人的資源の管理、総務、情報など）」の項目ごとに、気候関連のリスクと機会を網羅的に抽出しました。

次に、抽出した気候関連のリスクと機会の中から、それぞれのリスクと機会の影響の大きさと発生可能性を3×3のマトリックスで評価し、ディスプレイ製造装置および成膜装置事業、グラフィックアーツ機器事業にとって重要な気候関連のリスクと機会を特定しました。また、各事業における評価を基に、当社グループにおける重要な気候関連のリスクと機会も特定しました。

1. バリューチェーンの活動項目ごとの、気候関連のリスク・機会の洗い出し
2. 気候関連のリスク・機会の発生の可能性と影響の大きさを評価
3. 各事業における重要な気候関連のリスク・機会の特定（重要性が大）
4. 当社グループにおける重要な気候関連のリスク・機会の特定（重要性が大）

気候関連のリスク・機会の評価基準

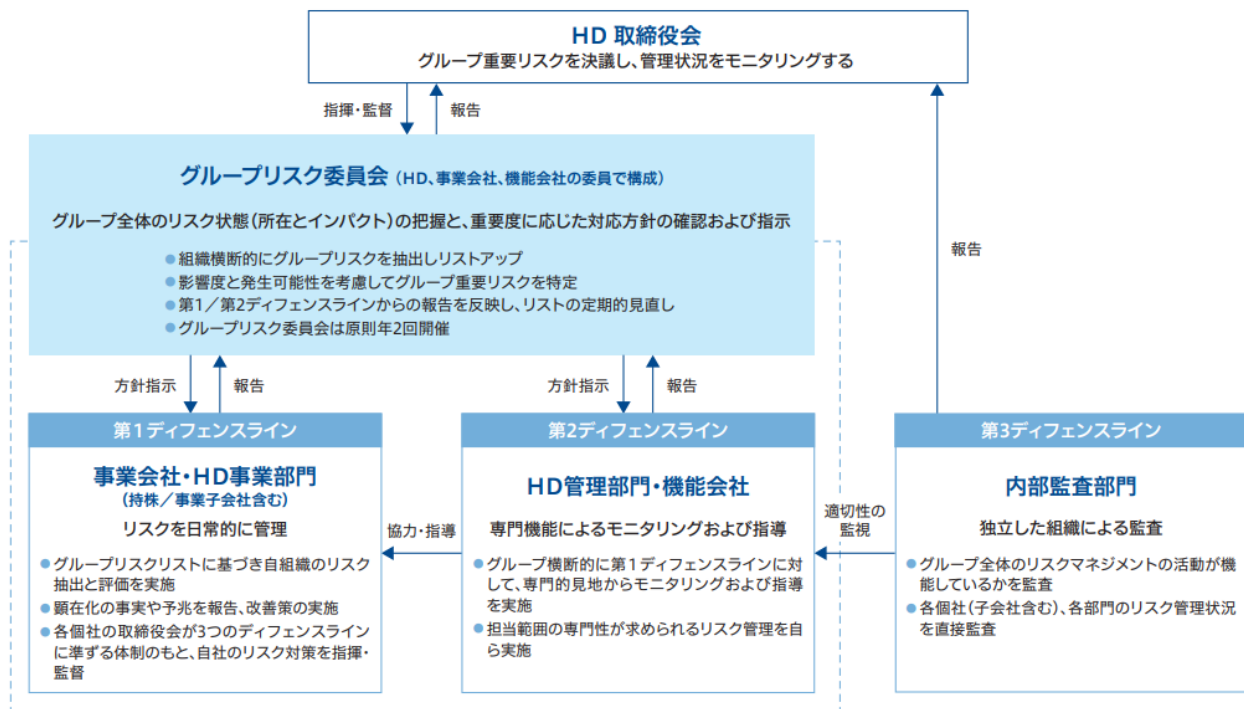


気候関連のリスク管理の実施体制

当社グループは、上述のプロセスを経て重要と評価された気候関連のリスクと機会について、取締役社長を最高責任者とし、各グループ会社の社長を各社のリスクマネジメント責任者とする全社横断的なリスクマネジメント体制である「グループリスク委員会」においてリスク管理を行い、取締役会による監督体制の下、当社グループにおける企業リスクの一つとして戦略に反映し対応します。

グループリスク委員会では、グループリスクリストの中から特に影響が大きい（または大きくなる可能性が高い）リスクを協議の上、当期のグループ重要リスクとして選定し、持株会社の取締役会の決議を得て決定しています。2023年3月期は、「気候変動」をグループ重要リスクのリスクカテゴリーの一つとして決めました。グループリスク委員会で議論されたリスク管理状況と必要な対策については、持株会社の取締役会に報告しています。

また、グループリスク委員会のもと、3つのディフェンスライン（事業会社系グループ会社を第1ディフェンスライン、持株会社の管理部門と機能会社を第2ディフェンスライン、内部監査部門を第3ディフェンスライン）の考え方で、リスク管理の担当と役割を定め、現場と経営層がリスク情報を共有するガバナンス体制を構築しています。



4. 指標と目標

気候変動に関連する指標と目標

当社グループは、CO₂排出量を削減し、事業を通じて脱炭素社会の実現に貢献することが、気候関連リスクの低減と機会の増大につながると考え、事業活動によるCO₂排出量 (Scope1+Scope2) に加え、特に排出量が大きく顧客の関心も高い、販売した製品の使用によるCO₂排出量 (Scope3カテゴリ-11) の削減に取り組んでいます。

指標と目標

指標	SBT基準年 (2019年3月期)	中間目標 Sustainable Value 2023 (2024年3月期)	SBT (2030年)
事業活動によるCO ₂ 排出量 (Scope1+Scope2)	50.6千t-CO ₂ e	10%削減 45.5千t-CO ₂ e	30%削減 35.4千t-CO ₂ e
販売した製品の 使用によるCO ₂ 排出量 (Scope3カテゴリ-11)	2,603千t-CO ₂ e	8%削減 2,395千t-CO ₂ e	20%削減 2,082千t-CO ₂ e

なお、当社グループのCO₂排出量の削減目標は、気温上昇について2°Cを十分に下回る水準に抑えるために必要な削減量と整合的な目標として、SBT認定を受けていますが、SBTとしての認定を更新するため、事業活動によるCO₂排出量の削減目標を、気温上昇を1.5°Cに抑制するために必要な水準に見直し、2024年3月期中にScience Based Targetsイニシアチブ (SBTi) への再申請を予定しています。新たな目標は2019年3月期比50%を超える削減水準で設定する予定です。

CO₂排出量の実績

CO₂排出量は、GHGプロトコルにのっとり算定しています。

2023年3月期における、事業活動によるCO₂排出量 (Scope1+Scope2) は、2022年3月期中に実施した彦根事業所などでの再生可能エネルギー導入が通期寄与したことを主因として、基準年度比で52.7%の大幅削減を実現し、2030年の現行SBTについても前倒しで達成しました。

2023年3月期の実績は、再設定を予定している気温上昇1.5°Cと整合的なSBT並みの削減を実現しているものと考えられますが、当社グループでは、再生可能エネルギーのさらなる導入、設備の省エネルギー化やBCPも考慮した創出・蓄電を含む各種施策について検討を進めており、2050年のカーボンニュートラルに向けて、積極的なCO₂排出量削減を継続する方針です。

Scope1、Scope2の実績

(t-CO₂e)

	2019年3月 (SBT基準年)	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
Scope1	11,617	12,596	10,614	11,023	9,812
Scope2	38,949	42,198	40,056	33,638	14,007
Scope1+Scope2	50,566	54,794	50,670	44,661	23,889

※Scope2はマーケット基準で算出

2023年3月期における、販売した製品の使用によるCO₂排出量（Scope3カテゴリ-11）は、基準年度比で0.9%削減となり、製品販売の増加と比べ大幅に抑制されているものの、2024年3月期の中間目標（基準年度比8%削減）や2030年のSBTに対する進捗が遅れています。目標の達成に向け、当社グループ単独での取り組みに加え、業界他社や業界団体とも協働し、省エネルギー性能の高い製品の開発に一層注力していきます。

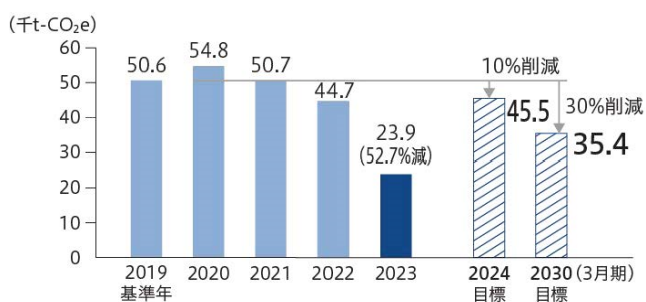
なお、販売した製品の使用によるCO₂排出量に関するSBTについては、事業活動によるCO₂排出量のSBTの見直しと合わせて、原単位への見直しを検討しております。

Scope3の実績

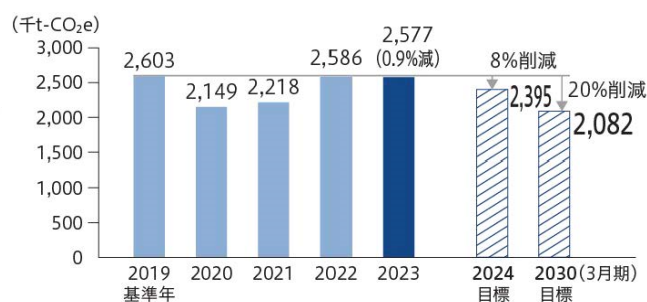
(千t-CO₂e)

	2019年3月期 (SBT基準年)	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
Scope3	3,194	2,597	2,633	3,160	3,284
販売した製品の使用 (Scope3カテゴリ-11)	2,603	2,149	2,218	2,586	2,577

<事業活動によるCO₂排出量>



<販売した製品の使用によるCO₂排出量>



グリーンプロダクツ

販売した製品の使用によるCO₂排出量を低減させる取り組みとして、当社独自の評価基準をクリアした製品を「グリーンプロダクツ」として認定し、環境性能の高い製品の販売拡大に努めています。消費エネルギーについては、製品環境アセスメントの基準とした従来製品に対して25%以上の削減を基準とし、製品のエネルギー消費量の最小化を図るとともに、「省エネルギー」「省資源」「分解性」「再資源化」「環境保全性・安全性」「情報の提供」の各項目を5段階で評価しています。

また、販売した製品の使用によるCO₂排出量の削減を一層加速させるため、より優れた省エネルギー性能を備えた「スーパーグリーンプロダクツ」認定制度の運用を開始しました。2019年3月期の販売製品と比べて、単位処理面積あたりの消費エネルギーを40%以上削減することを基準とし、今後、認定製品の創出に向けた開発を加速させていきます。

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
認定製品数 (累計)	144	152	163	166	175
売上高占有率 (%)	94	92	93	92	93

以上